

受託試験メニュー：冷熱衝撃装置 (300℃タイプ)



次世代パワー半導体向け300℃仕様冷熱衝撃装置を新たに導入。
幅広い温度領域での環境試験に対応可能です。

内藤電誠工業(株)



写真提供: ESPEC

冷熱衝撃試験機: TSA-73EH-W 300℃タイプ



特徴

幅広い温度制御範囲

低温側: $-70^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

高温側: $+300^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

⇒従来機 (Max $+200^{\circ}\text{C}$)

高温度域の拡大制御が可能です。

テストエリア内寸:

W410×H460×D370mm

次世代パワー半導体と試験要求

次世代パワー半導体の需要拡大

次世代パワー半導体 (SiC、GaN等) は従来のパワー半導体 (Si) と比較し

- ・電力損失低減→効率向上・省エネ
 - ・**高温動作可能 ($200^{\circ}\text{C} \sim$)** →冷却機構の小型化・省略可能
- の様な利点があり需要拡大が期待されています。

次世代パワー半導体試験要求

次世代パワー半導体は大電流による高温域での使用が想定されており現状試験機の限界温度 $+200^{\circ}\text{C}$ を超える温度での耐熱性が求められます。



写真提供: ESPEC

内槽

内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

〒213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496 FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp>